

FINE SEMITECH CORP.

INVESTOR RELATIONS



Disclaimer

본자료에포함된(주)에프에스티(이하“회사”)의경영실적및재무성과와관련한모든정보는기업회계기준및국제회계기준에따라작성되었습니다.

본자료는향후매출계획등미래에대한“예측정보”를포함하고있습니다.이는과거가아닌미래의추정에기인하며성장가능한목표치를경영실적으로 반영하고있으며,‘예상’,‘전망’,‘계획’,‘기대’등과같은용어를사용하였습니다.

위“예측정보”는경영환경의변화에따라적지않은영향을받을수있으며,이러한불확실성에따른현상은미래의경영실적과중대한차이가발생할수도있습니다.

또한각종지표들은현재의시장상황과회사경영목표및방침을고려하여작성된것으로시장환경의급속한변화및투자환경,회사의전략적목표수정에

의하여그결과가다르게나타날수있습니다.본자료에열거한주요사항은어떠한경우에도투자자의투자결과에효과를미치지못하므로법적인책임이없으며,

회사는새로운정보및미래의사건등으로그사실을공지할의무가없습니다.

INVESTOR RELATIONS 2024

FINE SEMITECH CORP.

CONTENTS

Chapter 01.

COMPANY OVERVIEW

- 1-1 회사개요 및 주식현황
- 1-2 회사연혁
- 1-3 FST 조직도

Chapter 02.

FST 주요 사업부

- 2-1 Pellicle 사업부
- 2-2 TCU 사업부

Chapter 03.

R&D Activities

- 3-1 EUV FLOW
- 3-2 EUV Pellicle
- 3-3 EUV Source
- 3-4 EUV Infra Tools

Chapter 04.

FST 자회사 소개

- 4-1 (주)에스피텍
- 4-2 (주)화인세라텍
- 4-3 (주)에프엑스티
- 4-4 (주)오로스테크놀로지
- 4-5 (주)이솔

Chapter 05.

재무제표 및 예상 손익

- 5-1 연도별 재무제표(연결기준)
- 5-2 사업부별 매출 추이
- 5-3 영업실적 및 예상 손익

FST

01

Chapter 01.

COMPANY OVERVIEW

- 1-1 회사개요 및 주식현황
- 1-2 회사연혁
- 1-3 FST 조직도



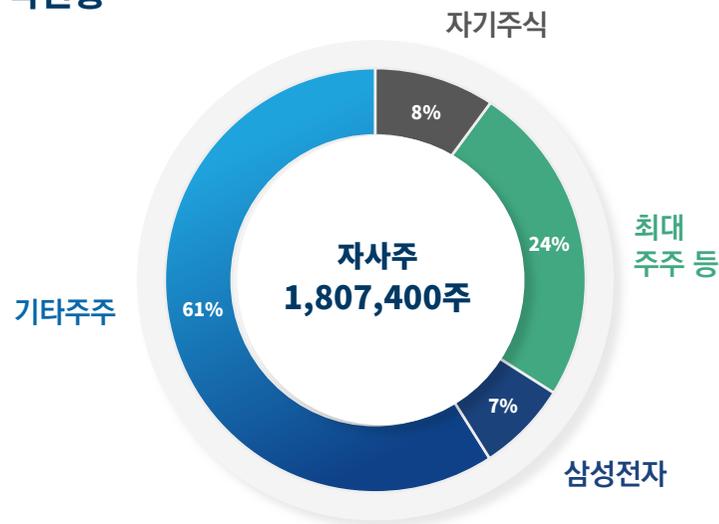
■ FST 개요

회사명	국문: (주)에프에스티 영문: FINE SEMITECH CORP. (FST)
대표이사	장경빈
설립일	1987년 09월 29일
사업영역	반도체 소재, 반도체 장비 등
주요제품	펠리클, 칠러, 검사 및 계측 장비, EUV 광원 등
자본금	110억원
소재지	본사 - 경기 화성시 동탄산단 6길 15-23 공장 - 경기 오산시 가장산업동로 14-18
임직원수	834명 (2024.12월 기준)
상장일	2000년 01월 18일
재무정보	2024년 매출 2,374억, 영업손실 23억, 당기순손실 -16억

■ 주요 임원

대표이사 장경빈	사외이사 이준호	現공주대학교광공학과교수 KAIST인공위성연구센터선임연구원 Univ.of London (UCL), PhD
Washington University in st.Louis 경제학졸업 Tsinghua - INSEAD EMBA (전) 이철 경영총괄 부사장 (전) 에프에스티 신사업총괄 상무이사	사외이사 박근원	現티에스이 상근감사 Sr. VP of Asia Operations & R&D of DuPont Photomasks Inc. 및 DuPont Photomasks Korea Ltd. 대표이사
이사회 의장 장명식	사내이사 윤지영	Photonics 기획실 / MOC부, 이사 University of Southern California 행정학 석사
서강대학교물리학과졸업 LAM Research Korea 대표이사역임		

■ 주식현황



■ 개요

주당 액면가	500원
발행주식총수	21,956,348주
자본금	110억원

■ 지분현황

자사주	1,807,400주 [8.23%]
최대주주 등	5,332,624주 [24.29%]
삼성전자	1,538,205주 [7.01%]
기타주주	13,278,119주 [60.47%]

창업기

- 1987.09 화인반도체(주) 설립
- 1988.05 Pellicle 국내생산성공
- 1989.08 기업부설연구소 설립
- 1993.09 Deep-UV(KrF) Pellicle 개발
- 1994.04 제8회 벤처기업대상 수상
- 1994.12 ISO9001 인증 획득
- 1998.11 Thermo-electric Chiller 개발
- 1999.06 Deep-UV(ArF) Pellicle 개발

준비기

- 2000.01 KOSDAQ 상장
- 2000.02 CE마크 획득(칠러)
- 2001.01 기흥공장 준공 및 본사이전
- 2001.08 상호변경 - (주)에프에스티
- 2004.02 LCD용 펠리클 개발 완료
- 2005.09 윤리경영 선포
- 2006.01 ISO140010 인증 획득
- 2007.03 영문상호 변경
(FST INC → FINE SEMITECH Corp.)

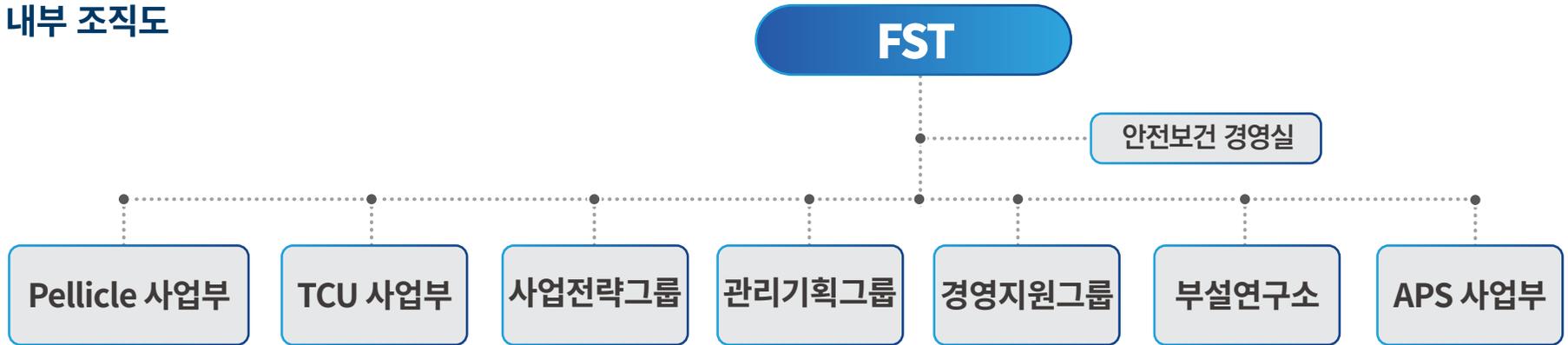
도약기

- 2011.11 오산공장 준공
- 2012.02 OHSAS18001 인증 획득
- 2012.10 동탄공장 준공
- 2012.12 EUVOTM 세계일류상품 선정
- 2013.02 칠러 생산 5천대 돌파
- 2013.02 ISO14064 인증 획득
- 2013.10 중국시안 법인 설립
- 2013.10 반도체 동탄산업단지 수훈
- 2014.03 직장어린이집 개원
- 2014.11 병역특례지정업체 인증
- 2014.12 펠리클 세계일류상품 선정

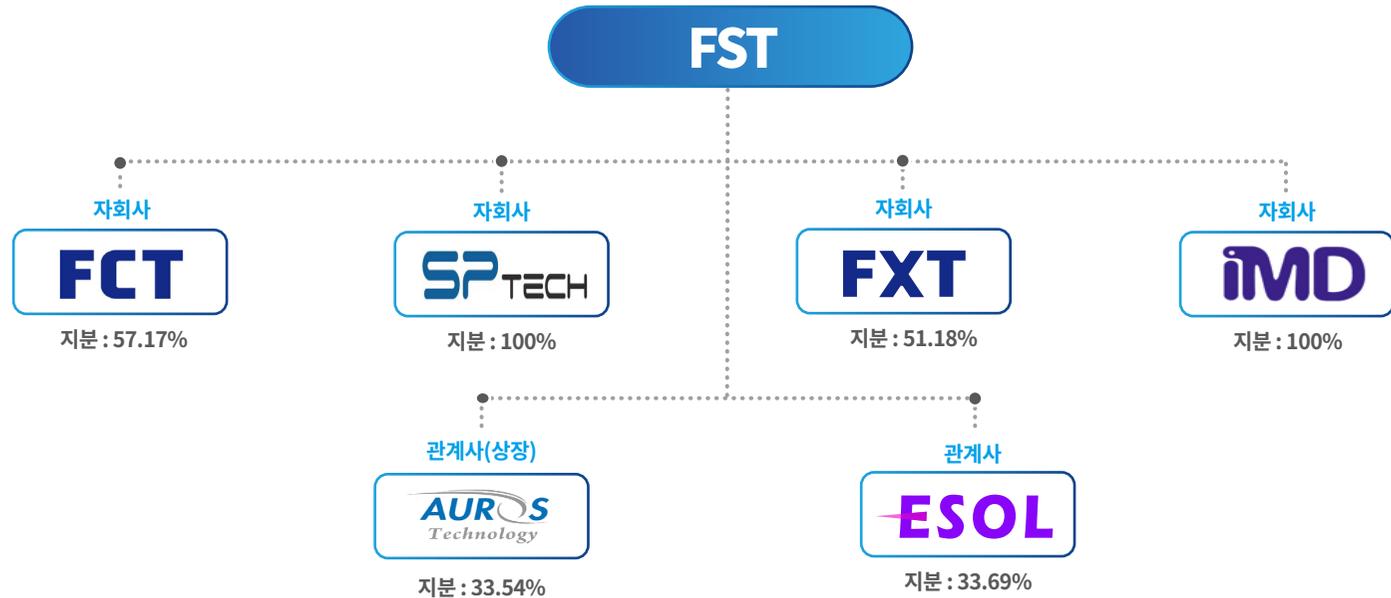
성장기

- 2015.10 칠러 생산 7천대 돌파
- 2015.12 삼성전자 EHS Role모델 인증
- 2016.01 동탄 본관동 신축
- 2016.07 ISO27001 인증 획득
- 2017.03 Scrubber관련 합작법인 설립
- 2017.09 OLED 측정장비 개발착수
- 2017.09 2017 벤처천역기업 선정
- 2017.10 칠러 1만대 돌파
- 2018.01 이슬 설립
- 2019.08 오산사업장 F라인 준공
- 2019.09 방교사업장 준공
- 2020.07 (주)화인세라텍 설립
- 2021.02 (주)에프엑스티 출자
(지분율 60%, 출자금 30억원)
- 2021.03 제3자 배정 유상증자
(보통주 1,522,975주, 대상자 : 삼성전자(주))
- 2022.01 미국 해외법인 설립
- 2023.04 교환사채 발행 (150억)
- 2025.03 주식배당 신주발행

■ 내부 조직도



■ 주요계열회사



FST

02

Chapter 02.

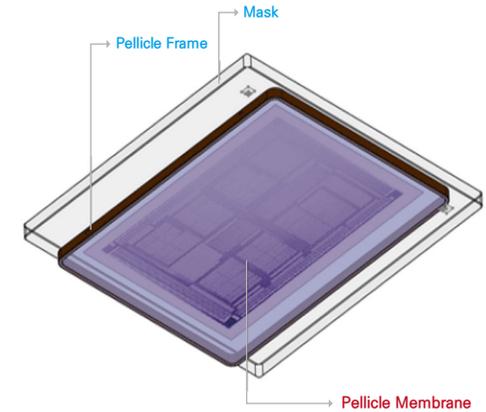
FST 주요 사업부

2-1 Pellicle 사업부

2-2 TCU 사업부

- **펠리클** : Photomask를 이물질(Particle)로부터 보호하기 위해 사용되는 소재
 <반도체 펠리클> <디스플레이용 FPD 펠리클>

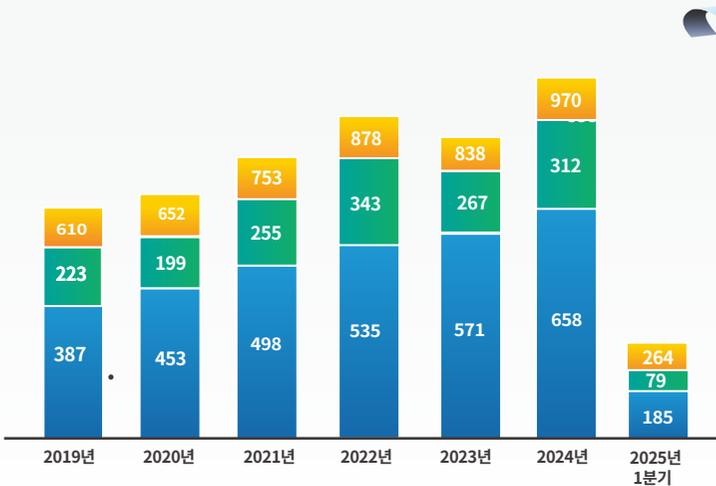
구분	주요고객사	경쟁사	경쟁력
반도체 FPD 펠리클	삼성전자 SK하이닉스 LG이노텍	日 신에쯔, 미쯔이 美 MLI, INKO	펠리클 전용공장 확보 (클린룸 10 class - 0.3um)



< 펠리클 매출추이 >

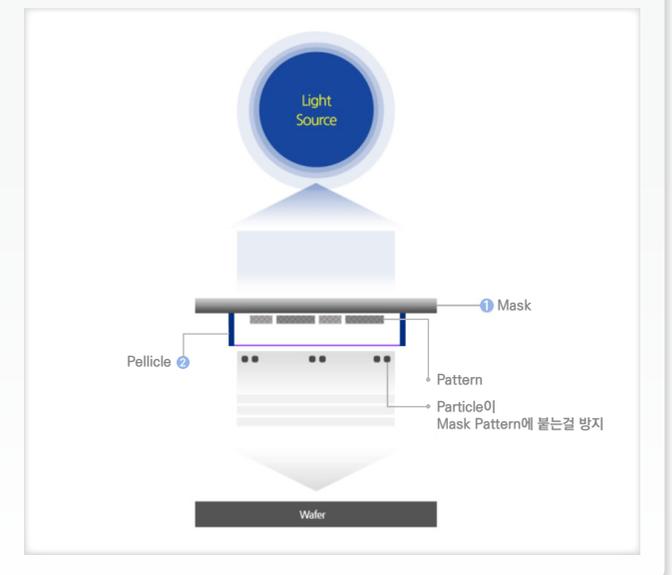
■ 반도체 ■ FPD ■ 합계

[단위 : 억원]



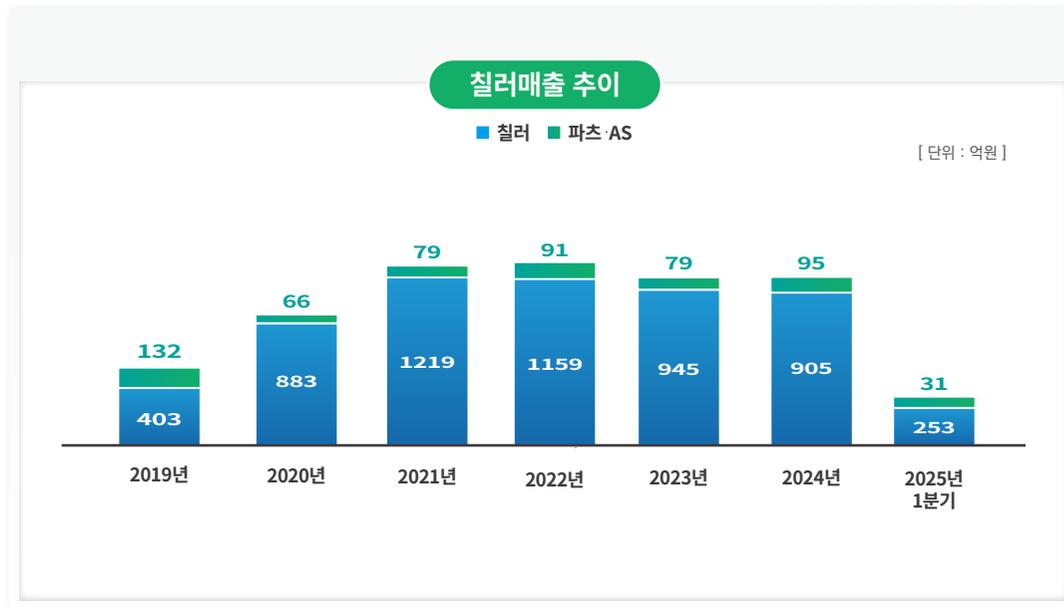
Light Source (Wavelength)	Pellicles
DUV ArF : 193nm	ArF Pellicles
DUV KrF : 248nm	KrF Pellicles
I Line : 365nm	I&G Pellicles
G Line : 436nm	

< 펠리클의 원리 >



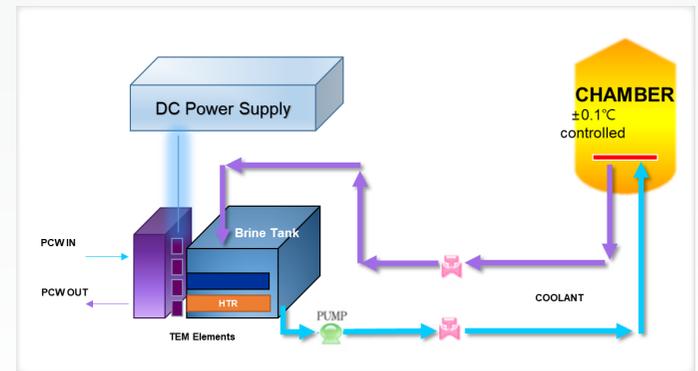
■ Chiller

:반도체 공정에서 과도한 열의 발생이 일어나는 장비 Chamber 內 Wafer나 주변온도를 일정하게 유지함으로써 공정효율을 개선하는 장비



< Chiller Mechanism >

-Thermo electric type



FST

03

Chapter 03.

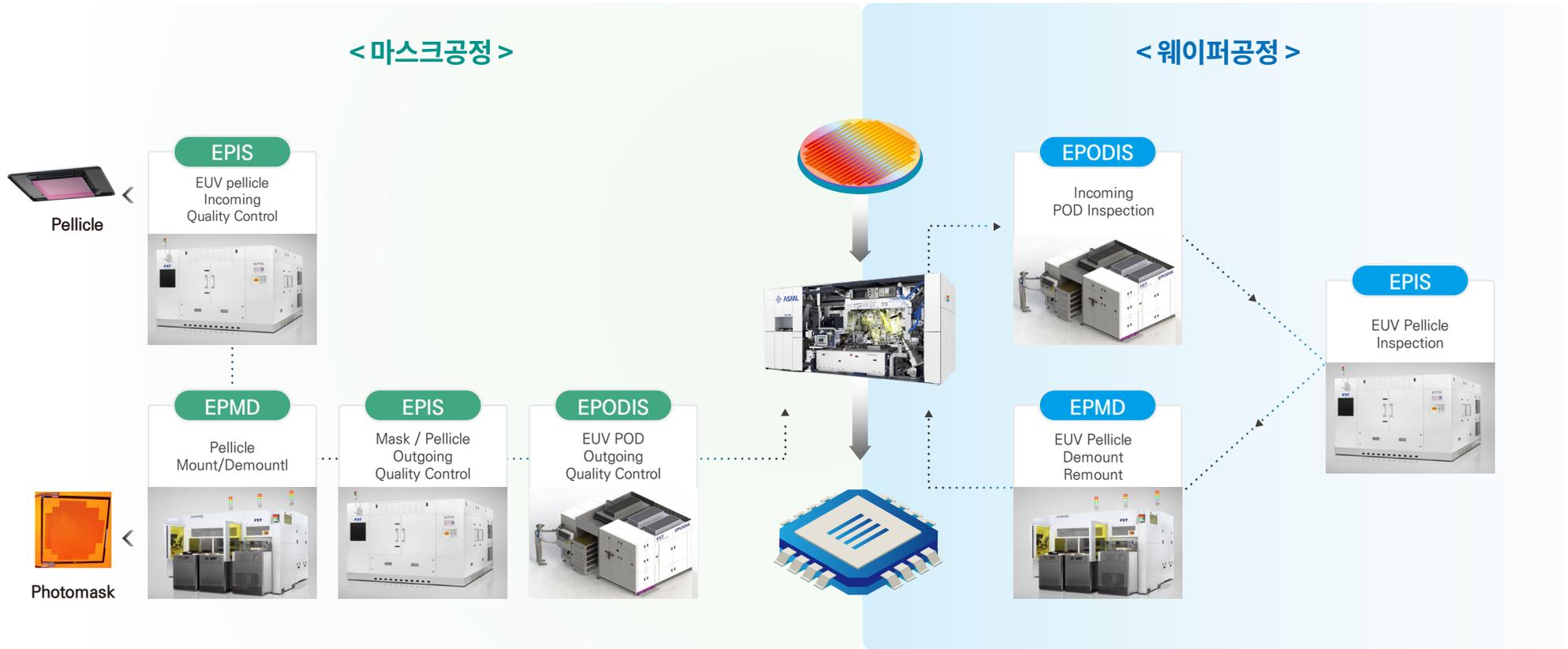
R&D Activities

3-1 EUV FLOW

3-2 EUV Pellicle

3-3 EUV Source

3-4 EUV Infra Tools



- PELLICLE** Photomask를 이물질(Particle)로부터 보호하기 위해 사용되는 박막필름
- EPODIS** EUV용 마스크 Case인 Dual Pod를 검사하는 장비
- EPMD** 노광 공정 전 EUV Pellicle을 EUV Mask에 자동으로 탈/부착하는 자동화 설비
- EPIS** EUV Pellicle의 Membrane과 Frame의 이물을 optical 방식으로 검사하는 장비

■ EUV Pellicle 개발 현황

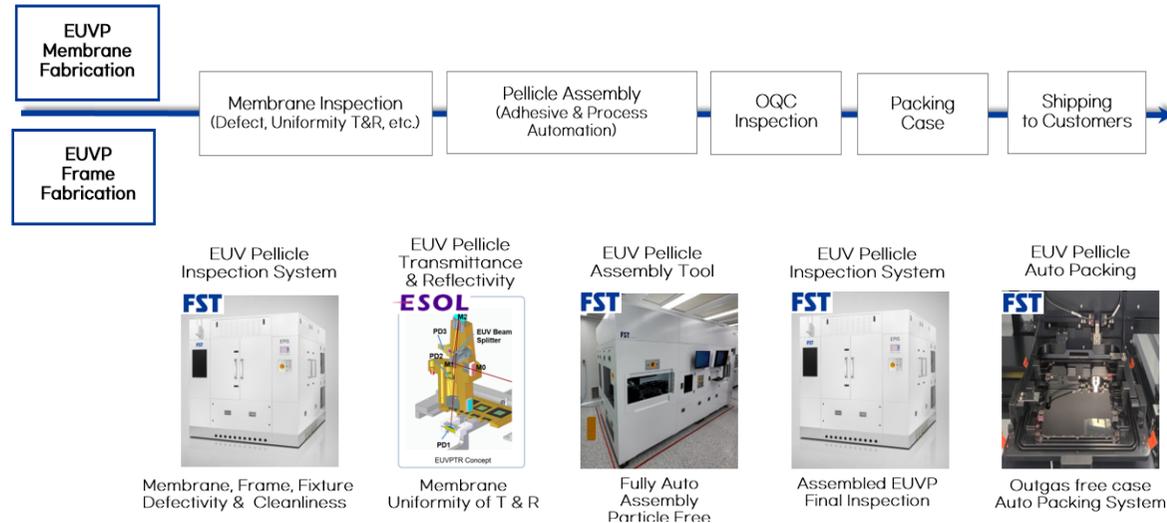


항목	기존 소재	FST CNT Pellicle
투과율	~88%	92~97%
Power	~400W	400~600 W
기계적 강도	~70Pa	>10kPa

■ 차세대 CNT 기반 EUV Pellicle 개발

- 기존 소재 대비 투과율 및 기계적 특성 우수
- 자체 개발 평가 인프라 기반 완전 자동화 제조 시스템 구축

■ EUV Pellicle 제작 인프라 및 공정 확보

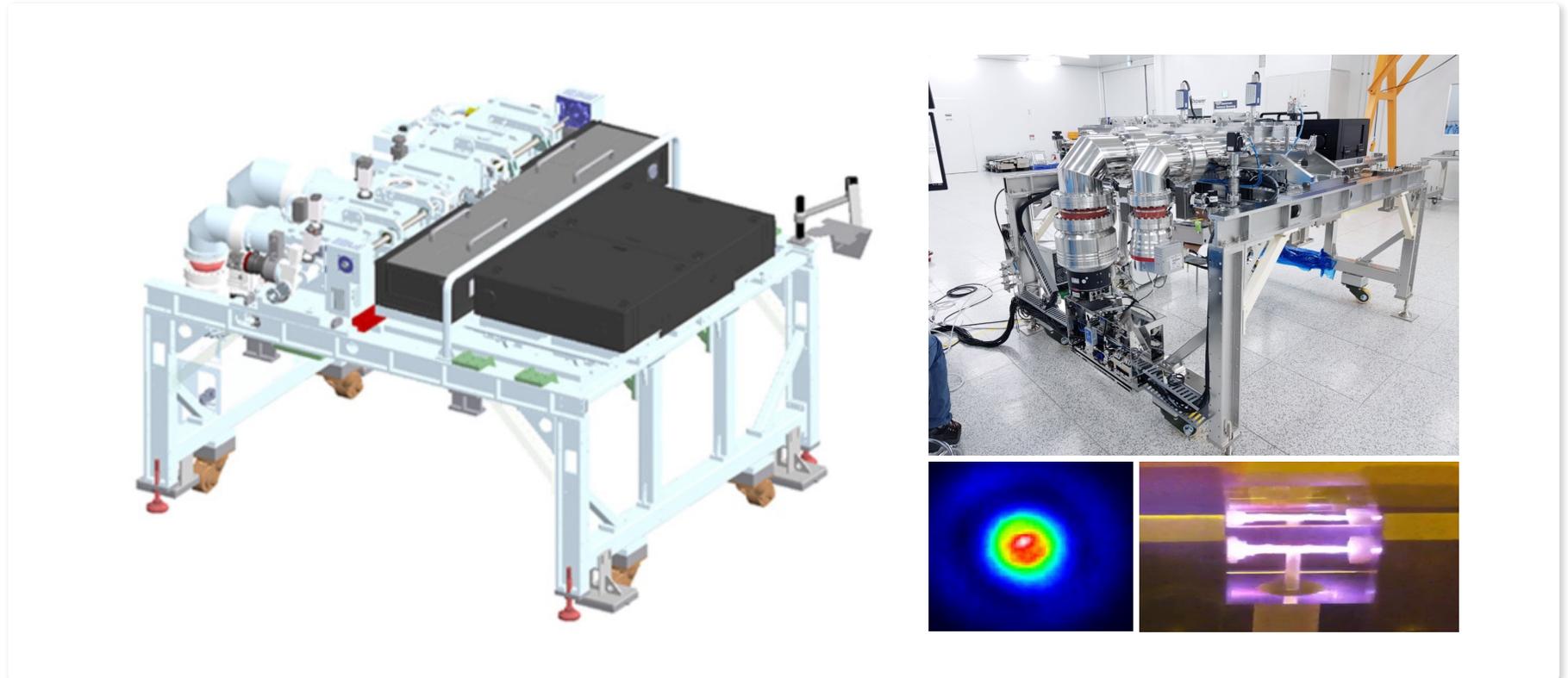


- 자체 제작한 인프라 장비를 기반으로 CNT Pellicle양산을 위한 전 공정 자동화 구축
- EUV Pellicle광학적 특성 평가 가능한 PTR설비 국내 유일 보유
- In-house 평가를 통한 다양한 소재 연구 개발 가능

■ 고차 조화파 (High Harmonic Generation) EUV

: Laser를 이용하여 Coherence가 높은 EUV 파장 (13.5nm)의 광을 형성하며, EUV 검사 및 계측 설비의 광원으로 활용

* HHG source의 power 향상 및 Laser-produced Plasma (LPP) Source 연구개발 중



EUV Pellicle Mounter & Demounter (EPMD)

: 노광 공정 전 EUV Pellicle을 EUV Mask에 자동으로
탈/부착하는 자동화 설비



■ EUV Pellicle Inspection System (EPIS)

: EUV Pellicle의 Membrane과 Frame의 이물을
optical 방식으로 검사하는 장비



■ EUV Pod Inspection System (EPODIS)

: EUV용 마스크 Case인 Dual Pod를
검사하는 장비



04

Chapter 04.

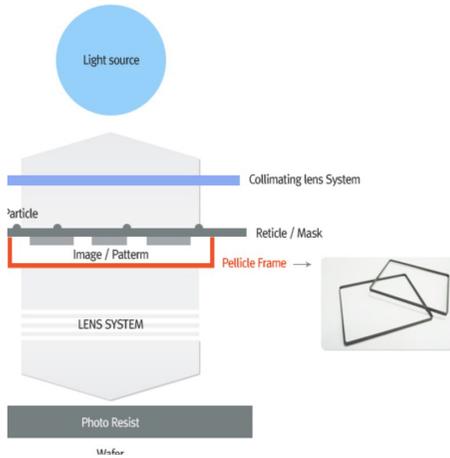
자회사 소개

- 4-1 (주)에스피텍
- 4-2 (주)화인세라텍
- 4-3 (주)에프엑스티
- 4-4 (주)오로스테크놀로지
- 4-5 (주)이솔

▪ SP TECH

(주)에스피텍

- 반도체 및 FPD 펠리클용 Frame 생산과 판매



▪ FCT

(주)화인세라텍

- 세라믹 소재 기술을 이용해 프로브 카드용 다층세라믹기판 (MLC, Multi Layer Ceramic Substrate)을 개발 및 생산

HTCC	LTCC
메모리용 MLC(DRAM/NAND)	비메모리용 MLC(CIS/AP)
Material : Mullite Size : ~12 inch	Material : Alumina, Mullite Size : ~8 inch
	무수축 MLC Material : Glass Powder Size : ~12 inch

▪ FXT

(주)에프엑스티

- 반도체 장비용 CVD SiC Ring 생산 및 판매



■ AURS Technology

(주)오로스테크놀로지

: 웨이퍼 측정. 웨이퍼 검사. 패키지측정. 패키지검사의 사업을 영위 주력인 OVERLAY 계측장비는 노광 공정 중회로패턴 형성 및 적층 과정에서 수직 적층에 대한 정렬도와 오정렬을 측정 및 제어하는 장비



■ ESOL

(주)이솔

- Actinic EUV Mask 계측 및 검사 장비
- EUV 간섭 노광장비
- EUV Pellicle 투과율/반사율 측정 장비



Chapter 05.

재무제표 및 예상 손익

5-1 연도별 재무제표(연결기준)

5-2 사업부별 매출 추이

5-3 영업실적 및 예상 손익

■ 재무상태표

[단위:백만원]

분류	2024	2023	2022	2021	2020
유동자산	143,687	105,158	102,141	109,161	77,417
비유동자산	362,456	303,677	292,617	236,715	146,809
자산총계	506,143	408,835	394,758	345,876	224,226
유동부채	159,195	100,463	90,073	74,029	52,081
비유동부채	102,813	68,597	58,933	63,154	38,270
부채총계	262,008	169,060	149,006	137,183	90,351
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	246,676	239,170	244,170	204,472	130,968
자본금	10,878	10,878	10,878	10,878	10,117
자본잉여금	94,208	86,952	82,029	82,097	39,175
자본조정	-5,813	-7,187	-7,370	-5,460	-5,460
기타포괄손익 누계액	-753	617	-1,505	-359	-737
이익잉여금	148,156	147,910	160,139	117,315	87,873
비지배지분	-2,541	605	1,583	4,222	2,907
자본총계	244,135	239,775	245,753	208,694	133,876
자본과부채총계	506,143	408,835	394,759	345,877	224,226

■ 손익계산서

[단위:백만원]

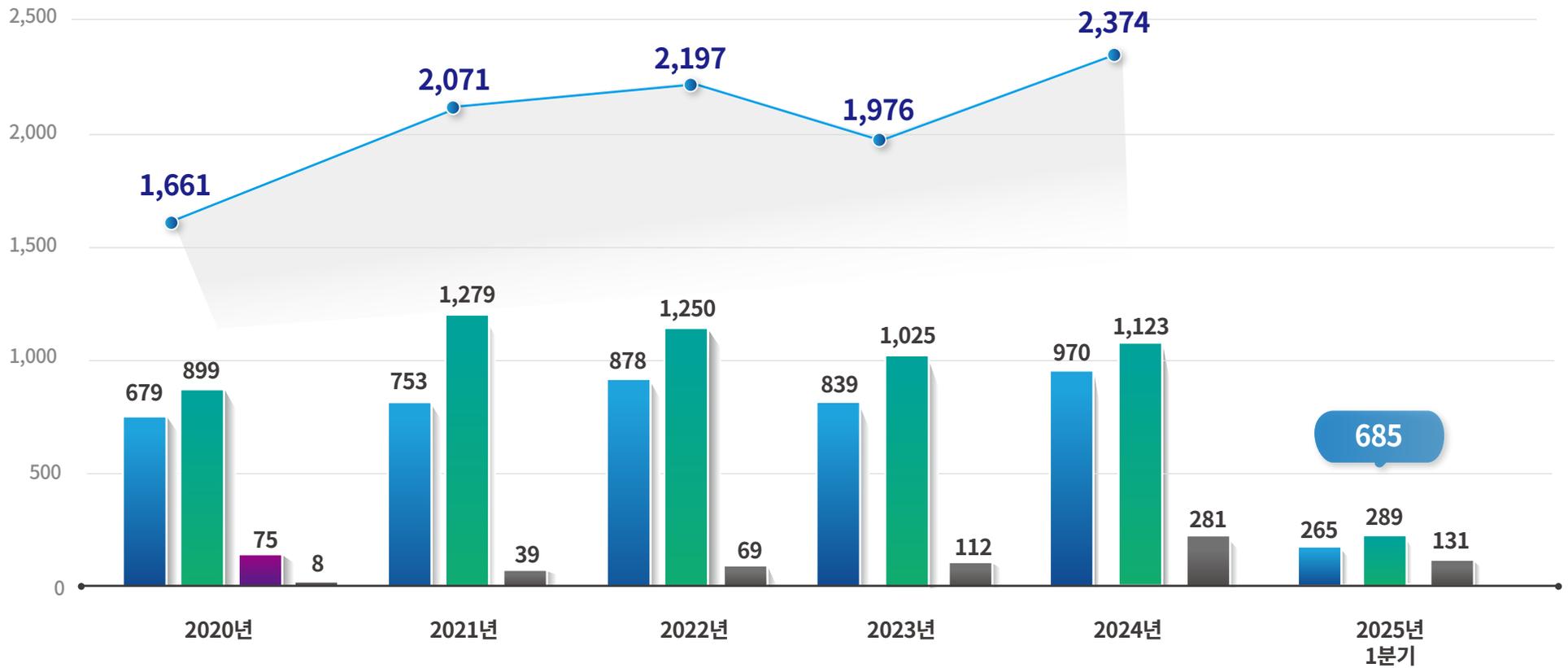
분류	2024	2023	2022	2021	2020
매출액	237,408	197,609	219,624	207,048	166,157
매출원가	156,894	131,318	141,431	125,605	105,736
매출총이익	80,514	66,291	78,193	81,443	60,421
판매비와 관리비	78,227	77,073	71,859	58,704	35,579
영업이익	2,287	-10,782	6,334	22,739	24,842
세전이익	-4,664	-19,943	41,228	35,485	23,324
법인세비용	-3,026	-1,965	318	7,156	4,637
계속영업이익(손실)	-1,638	-17,978	40,910	28,329	18,687
중단영업이익(손실)	-	-125	-71	-113	-
당기순이익	-1,638	-18,103	40,839	28,216	18,687
기본주당이익	73	-691	2,242	1,657	1,026

※ 반도체 칩 유통사업 중단사업제의 (2021년~ 2023년) 비교식 손익에 반영함.

재무제표 및 예상 손익_ 사업부별 매출 추이

■ 재료
 ■ 장비
 ■ 유통
 ■ 연결회사 & 기타

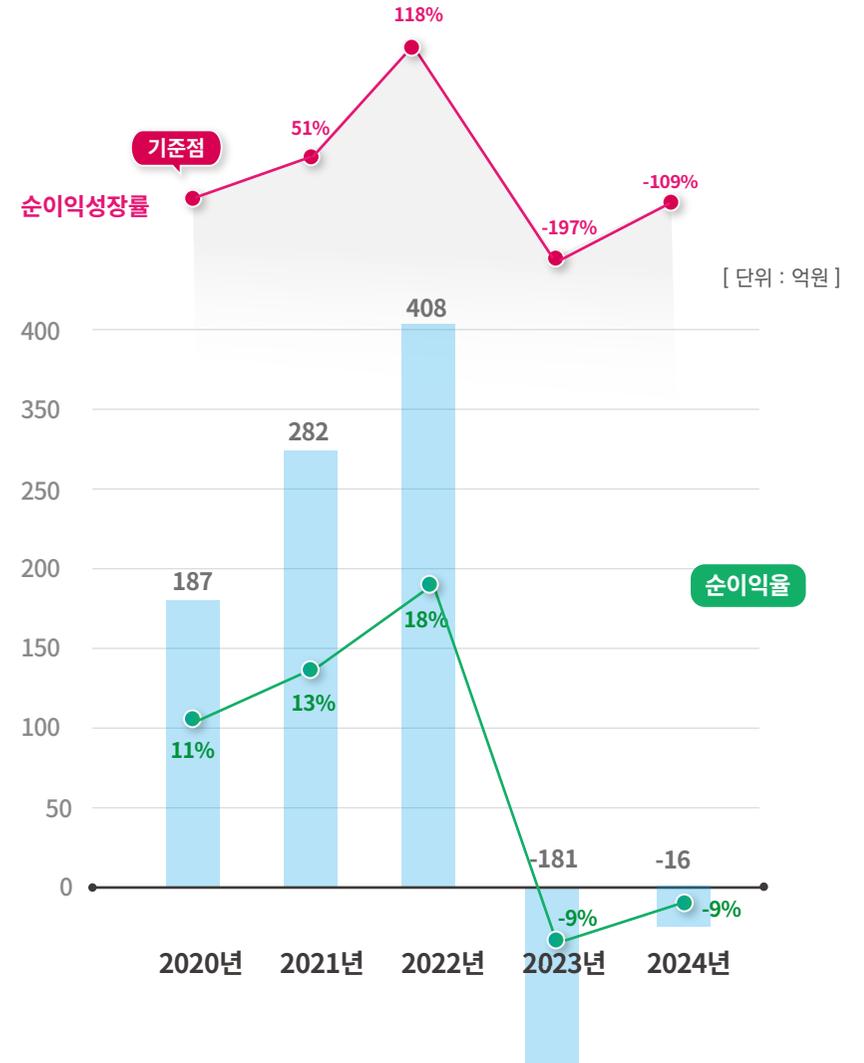
[단위 : 억원]



■ 영업이익 및 이익률 매출액 대비 영업이익률 (총액기준)



■ 순이익 및 순이익률 매출액 대비 순이익률 (총액기준)



THANK YOU

Q&A

FST